

## Product Overview

## SK-AM62-LP 设计包内容概述



表 1 列出了 SK-AM62-LP 中包含的文件夹名称、文件夹中的文件名称以及所有文件的格式。SK-AM62-LP 是基于 AM62x SoC ( 17.2mm x 17.2mm , 0.8mm 间距 , 441 引脚 FCBGA [AMC] ) 构建的低功耗、低成本 AM62x 入门套件 (SK) 评估模块 (SKEVM)。该处理器包含一个四核 64 位 Arm®-Cortex® A53 微处理器、一个单核 Arm Cortex-R5F MCU 和一个 Arm Cortex-M4F MCU。产品概述文档位于 TI.com 上的 SK-AM62-LP 产品文件夹中 , 供客户在下载单个 Zip 文件夹之前查看。

表 1. PROC124E2A

文件夹 ( 第 1 级 )	文件夹 ( 第 2 级 )	文件夹内的文件	文件类型
—	—	Proc124E2A_Folders_Files_List	XLS
1_SCHEMATIC	PDF	PROC124E2A_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	PDF
	PDF: Backup_SK_Schematic	proc124e2a_sch	PDF
	—	Proc124E2A_Schematic_Revision_Readme	DOC
	ORCAD	PROC124E2A_SCH_With_Design_Updates..Notes_V1.0	DSN
	ORCAD: Backup_SK_Schematic	PROC124E2A_SCH	DSN
2_BOM	—	PROC124E2A_BOM_With_Design_Updates..Notes_V1.0	XLS
	Backup_SK_Schematic_BOM	PROC124E2A_BOM	XLS
3_Board_File	Allegro	PROC124E2_BRD	BRD
	Simulation Scorecard	AM62x_Simulations_Scorecard	PDF
	Altium_ASCII	PROC124E2_BRD	ALG
4_Gerber	ODBGBR	PROC124E2_ODBGBR	ZIP
	274X	PROC124E2_274xGBR	ZIP
	IPC-D-356_NETLIST	PROC124E2_IPC	IPC
5_Gerber_PDF	FAB	PROC124E2_FAB	PDF
	PCB LAYERS	PROC124E2_Gerber-PDF	PDF
	Gerber Layers	PROC124E2_Gerber-PDF	PDF
6_Assembly_Models_Package	2D	PROC124E2_DXF_BASY	DXF
		PROC124E2_DXF_TASY	DXF
	3D	PROC124E2A_3D_STEP	STP
		PROC124E2_BRD	EMP
	IDF	PROC124E2_BRD	EMN
		PROC124E2_ASSEMBLY	PDF
	Assembly_Drawing	PROC124E2_TASY	PDF
		PROC124E2_BASY	PDF
		art_aper + 8 x .ART 文件	ART
	STNL	art_aper + 8 x .ART 文件	ART
XY-REP	PROC124E2	XLS	
7_PCB_LAYER_STACKUP	—	AM62X SKEVM_STACKUP_8L-14-2-2022-[0235]	PDF
8_Power_Supply_Sequencing	—	Proc124E2A_Power_Sequence	PDF

## 参考资料

- 德州仪器 (TI) , [\[常见问题解答\] AM625-Q1/AM620-Q1 定制电路板硬件设计 - 用于重复使用 SK-AM62-LP 原理图的设计和审阅说明 TI E2E™ 支持论坛](#)

## 商标

E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited.

所有商标均为其各自所有者的财产。

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司